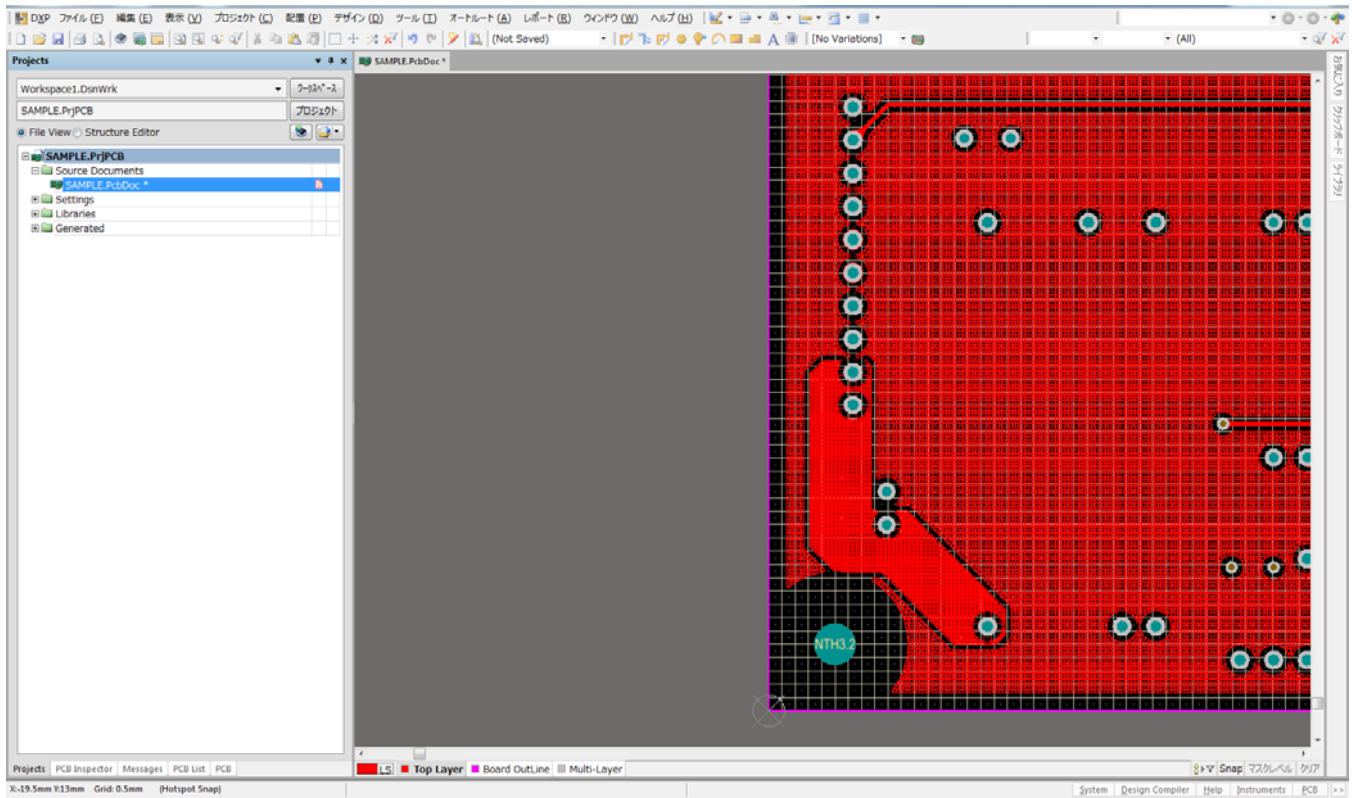
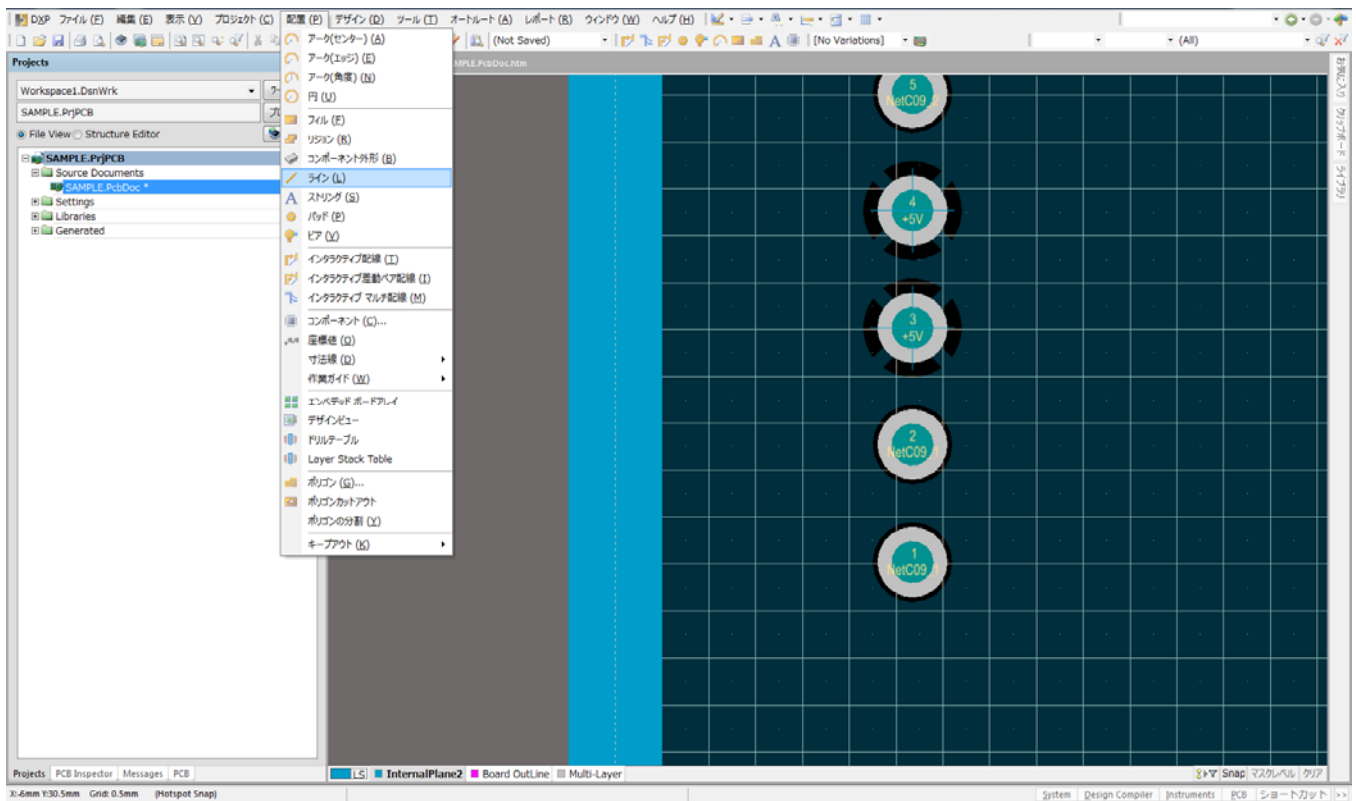


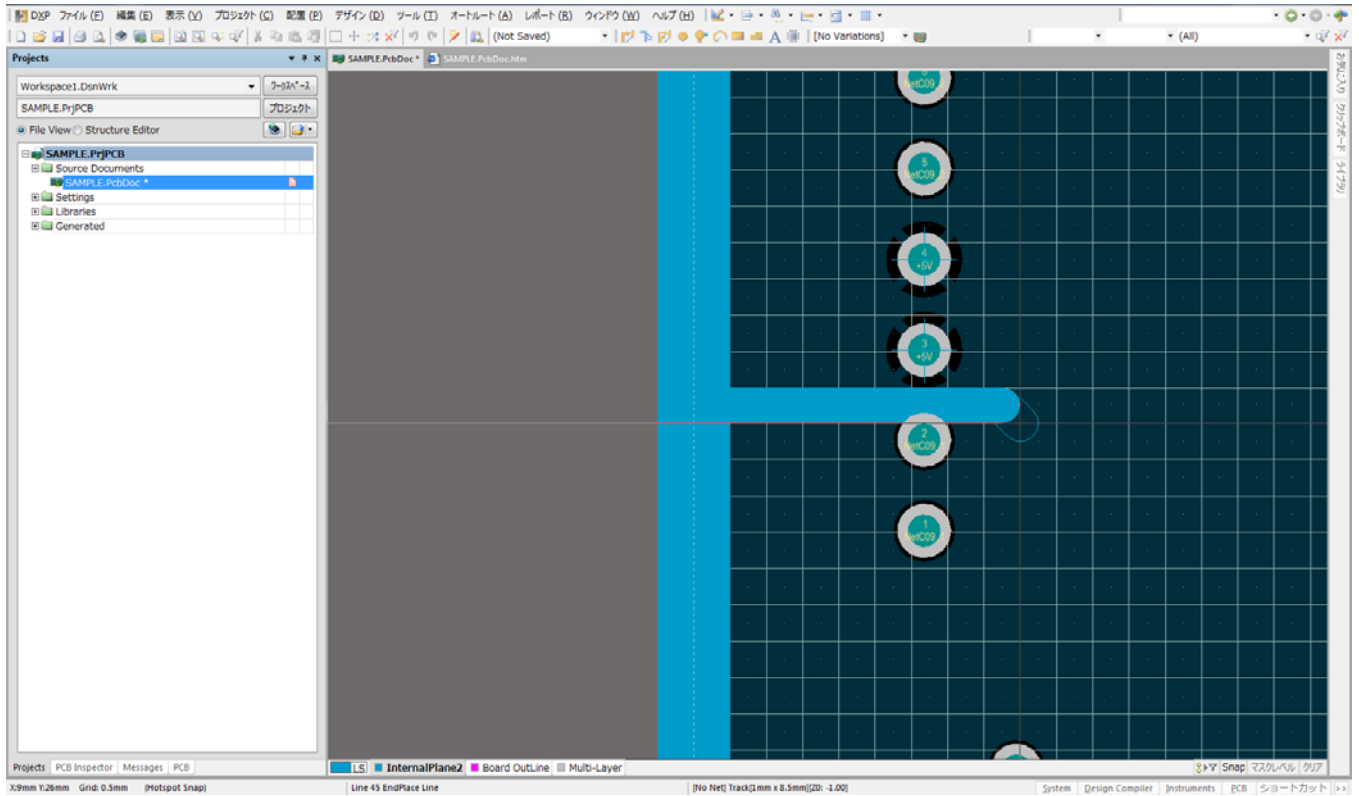
再表示させるとプライオリティの高い順に表示



内層（ネガ）の電源分離 配置>>ライン

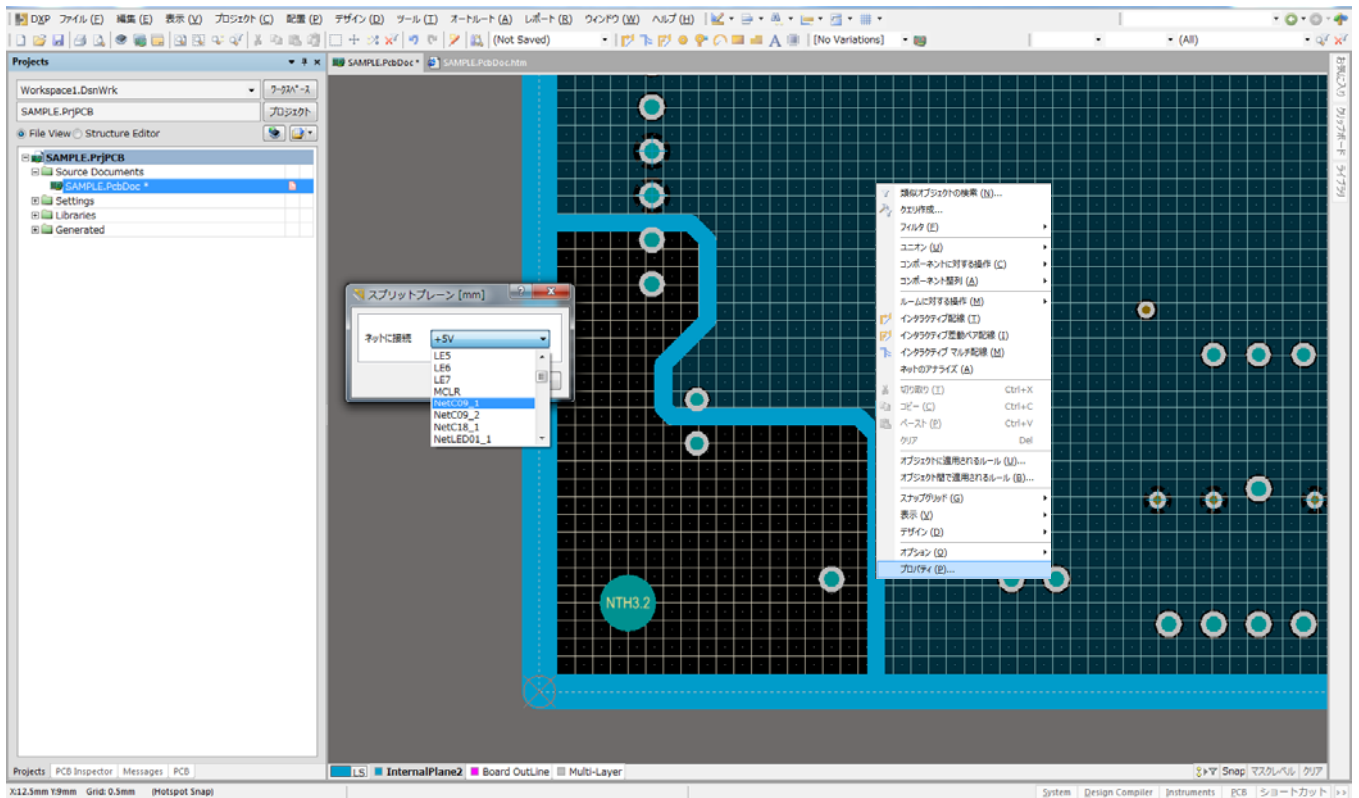


## 内層セパレートライン

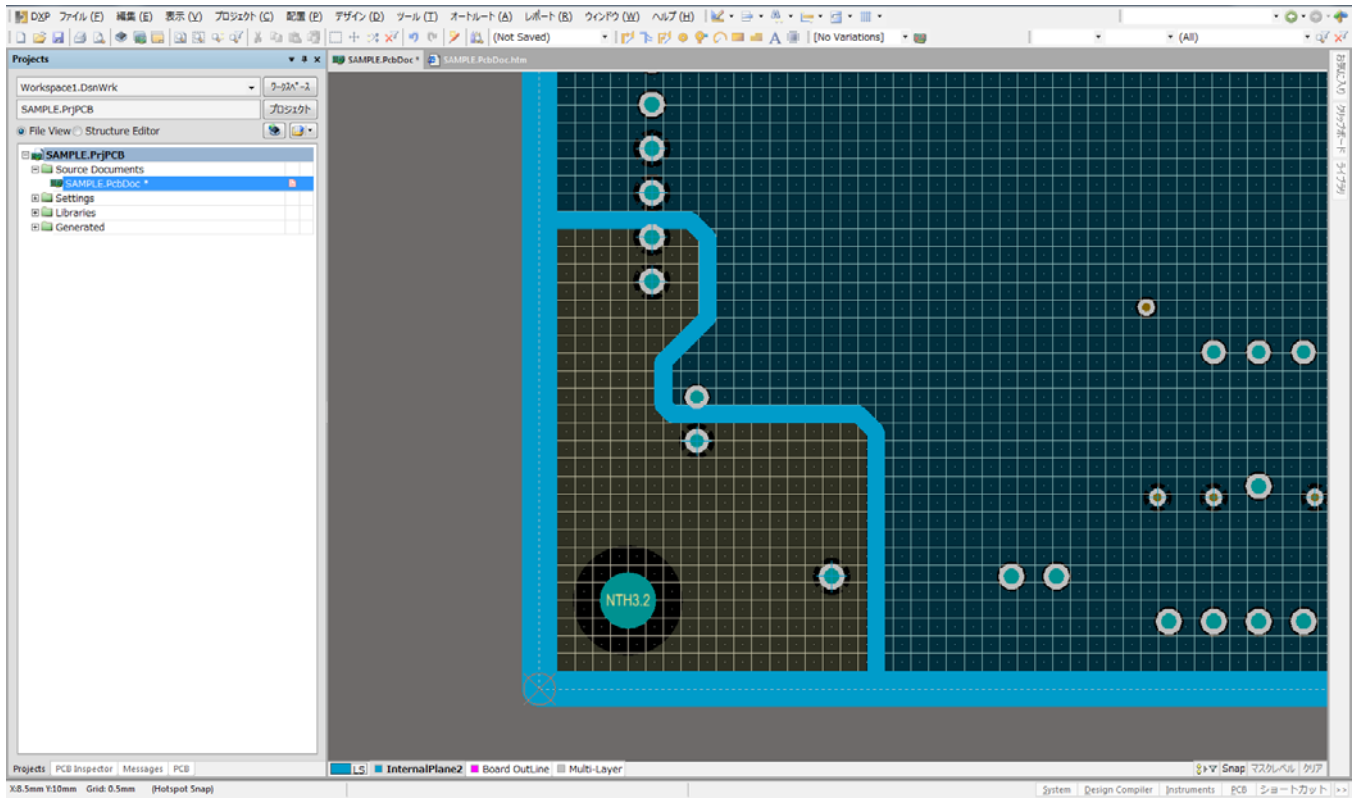


ライン幅 : 1.0mm 以上

分離したエリアにカーソルを移動しプロパティを開く

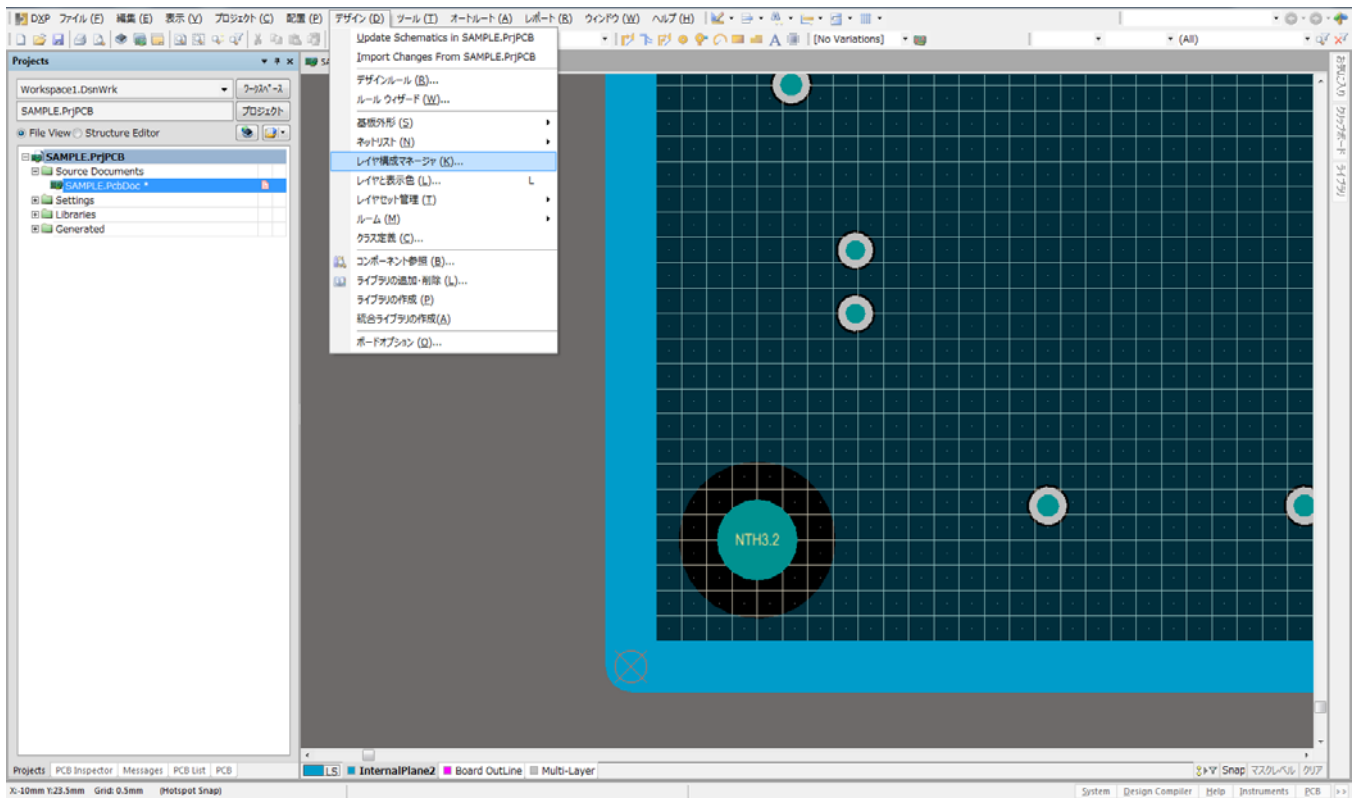


## ネットを指定

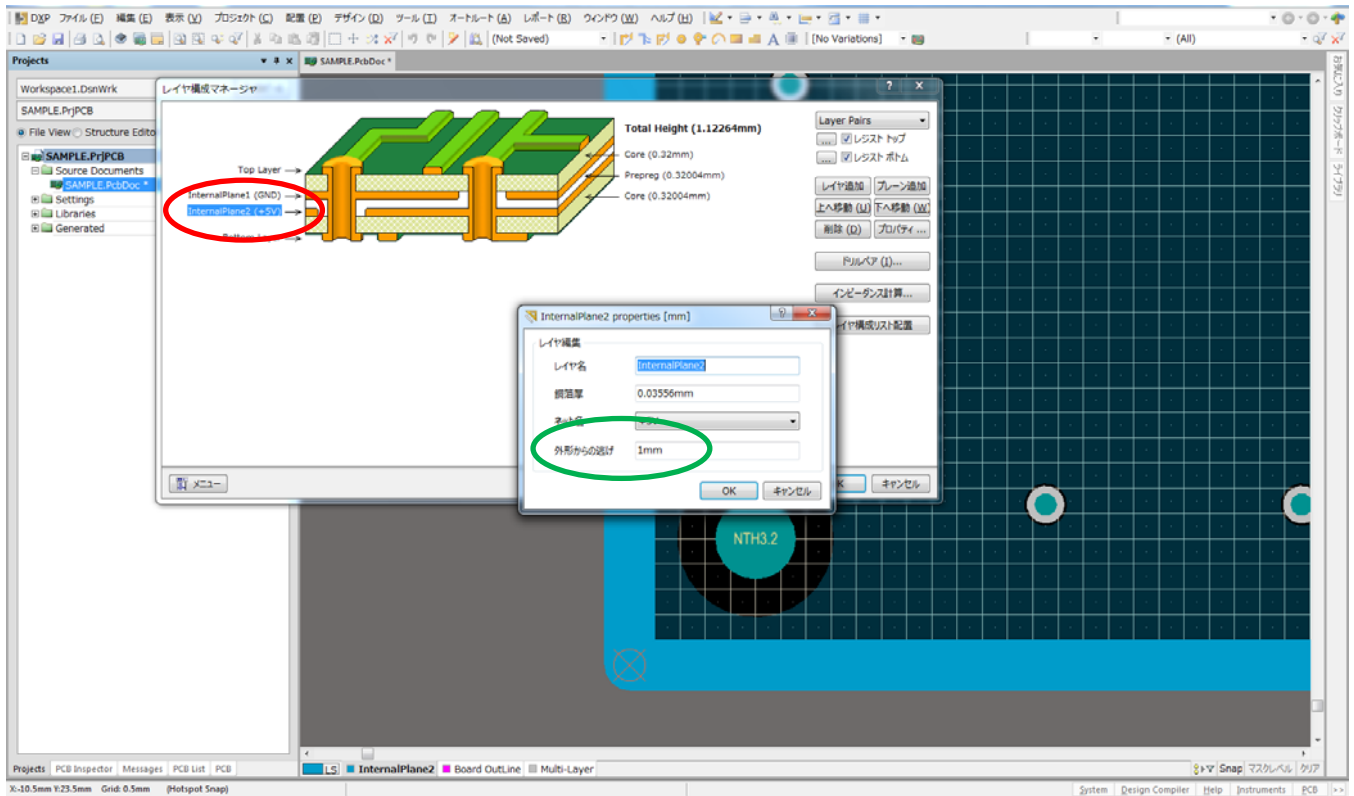


## 内層基板外形からの逃げ

## デザイン &gt;&gt; レイヤ構成マネージャー



赤印：InternalPlane2 をダブルクリック

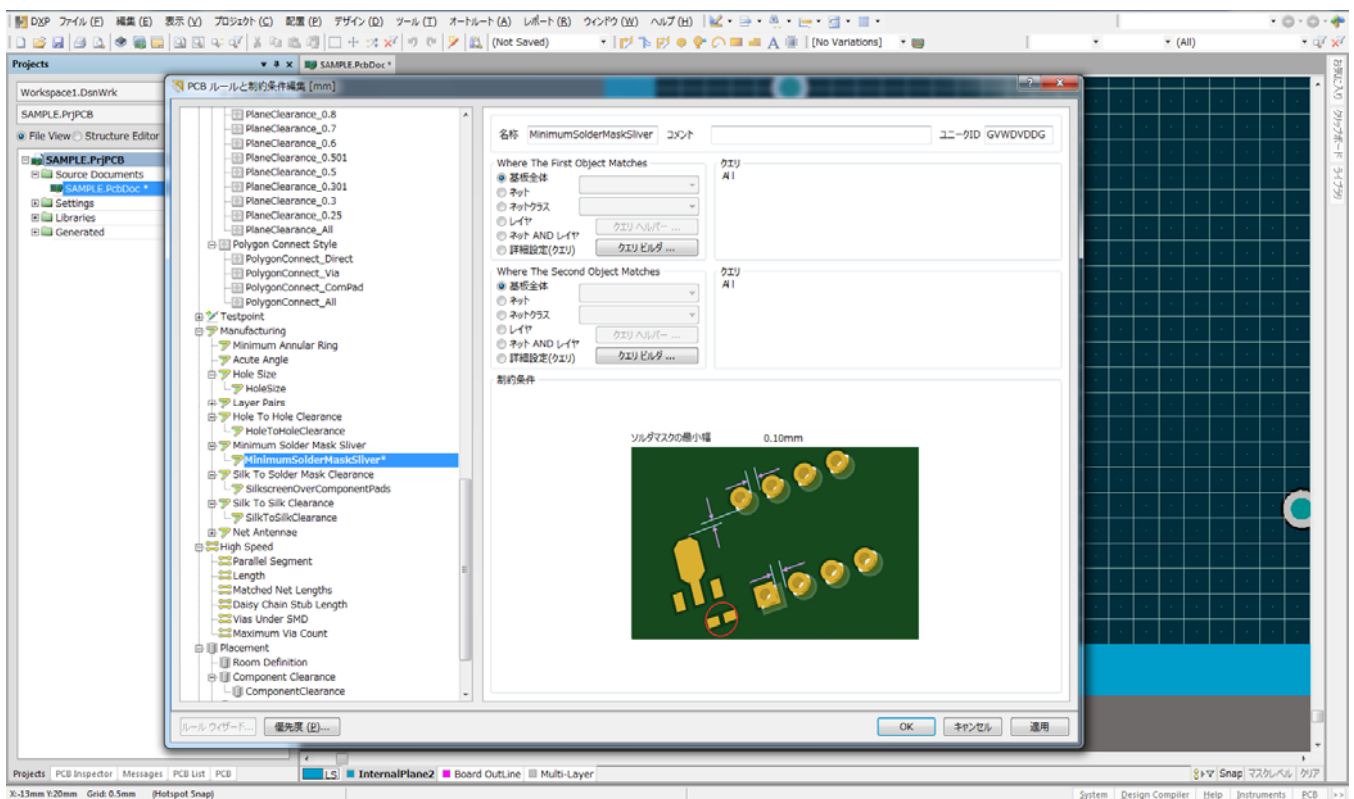


緑印：数値を設定

特に指定のない場合は 基板端から 1.5mmは、パターン禁止とする。

小形基板等で、1.5mm確保できない場合は 最小 0.75mmとする。

最小レジスト幅 Minimum Solder Mask Sliver



レジストが残る最小幅を 0.1mm以上とする。(QFP・コネクタなど要注意)

0.1mm 以下になってしまう場合は一括逃げとする。